

開示の要約

研磨装置

- 5 膜厚測定値に対応付けられる位置座標の精度を向上させることができる研磨装置が開示される。研磨装置は、研磨パッドの厚みを測定するパッド厚み測定装置と、基板に対して斜めに光を照射し、測定点の膜厚測定値を決定する光学式膜厚測定装置と、膜厚測定値に測定点の位置を示す測定座標に対応付ける制御装置とを備え、研磨パッドの厚みと測定座標の移動量との関係を示す相関データに基づいて研磨
- 10 パッドの厚みの測定値に対応する測定座標の移動量を決定し、決定された測定座標の移動量に基づいて膜厚測定値に対応付けられた測定座標を補正する。

図 1